

**Inhalt**

		Seite
<i>M. Saga</i>	Materials of Microtechnics — Material Developments in Electronics	1
<i>K. Ploog</i>	Stand und Perspektiven der Halbleiter-Vielschichtstrukturen	9
<i>H. K. Tönshoff und M. Klein</i>	Präzisionsbearbeitung von monokristallinem Silizium	29
<i>J. Engemann</i>	Dünne polykristalline Diamant-Filme für Mikroelektronik-Anwendungen	79
<i>D. Houdeau und L. Kiesewetter</i>	Bruchspannungsermittlung an Si-Wafermaterialien	107
<i>H. M. Keller, J. Engelmann, J. Banský und D. Korzec</i>	Nicht konventioneller Einsatz von Green-Tape Keramik-Filmen für mikrotechnische Anwendungen	123
<i>M. Popall, J. Kappel, M. Pilz und J. Schulz</i>	ORMOCERe: Strukturierbare Materialien für die Elektronik und Mikrooptik	139
<i>E. Arzt, J. Sanchez und W. D. Nix</i>	Mechanische Festigkeit von dünnen Schichten als Grundlage für Werkstoffe der Mikrotechnik	163
<i>J. R. Lloyd</i>	Modeling Electromigration Failure in Thin Films	179
<i>G. Blasek, W. Werner und S. Franz</i>	Lotwerkstoffe auf Indiumbasis — Eigenschaften Kristallwachstum intermetallischer Verbindungen	195
<i>Chr. Harendt, H. G. Graf, E. Penteker, W. Appel und B. Höfflinger</i>	Wafer Bonding, ein Verfahren zur Herstellung komplexer Strukturen für Mikroelektronik und Mikromechanik	209
<i>K. Reinking</i>	Kunststoffe in der Feinwerktechnik, Elektrotechnik, Elektronik	219
<i>H. Ahne, S. Birkle, R. Leuschner, M. Sebold und R. Sezi</i>	CARL — Photolacktechnik für feine Resiststrukturen mit hohem Aspektverhältnis	239

		Seite
<i>J. Göttert, J. Mohr und C. Müller</i>	Mikrooptische Komponenten aus PMMA, hergestellt durch Röntgentiefenlithographie	249
<i>D. Rüppel, H. Gernoth, B. Hoffmann, D. Jacvli, J. Magan und K. Witan</i>	Keramik/Metall/Polymer — Verbunde für Multilayer-Multichip-Module	265
<i>G. Machon</i>	Display und Bildschirme	285
 <b>Posterbeiträge</b>		
<i>R. Kasemann, H. Krug und H. Schmidt</i>	ORMOCERe (ORganically MOdified CERamics) als Werkstoffe in Mikrotechniken	303
<i>S. Wege und K. G. Schmitt-Thomas</i>	Verhalten von Weichlötverbindungen unter thermischer und mechanischer Beanspruchung	313
<i>F. Bartels, T. Muschik, W. Gust und H. Hieber</i>	Untersuchungen thermisch stabiler Mikroverbindungen aus intermetallischen Phasen	321
<i>M. Hilfer</i>	Nickelsperrschichten beim Weichlöten in der Elektronik	323
<i>U. Wallrabe</i>	Rotierende Mikrostrukturen als Grundlage für einen mikromechanischen Strömungssensor	327
<i>T. Harder</i>	Mikroverbindungen erhöhter Leistungsdichte	339
	Referenten, Diskussionsleiter und Programmausschuß	340